

## 株式会社テラミクロス

〒198-8555 東京都青梅市今井 3-10-6  
TEL 0428-32-1269 FAX0428-32-1225

## 株式会社テラプローブ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-7-17  
TEL 045-476-1011 FAX045-476-1012

2013年1月吉日

## 第14回半導体パッケージング技術展出展のご案内

2013年1月16日(水)～18日(金)の3日間に渡り、東京ビッグサイトにおきまして、半導体、パワーデバイス、センサ、LED、MEMSなどに必要な装置、部品・材料、受託サービスが一堂に出展する第14回半導体パッケージング技術展が開催されます。

弊社展示ブースでは、ウエハレベルパッケージ(WLP)及び基板埋め込み技術(EWLP)に加え、テラプローブグループによる、ウエハテスト以降の工程を一貫して提供するターンキーサービスについてご紹介いたします。

また、新たに WLP の採用を検討している方々に、WLP の特徴や優位性について解説し、WLP 導入に向けてのポイントをご説明いたします。

ご多忙のこととは存じますが、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

## ■ 開催概要

1. 期間 2013年1月16日(水)～18日(金)
2. 場所 東京ビッグサイト
3. ブース 東1ホール 東25-49

## ■ 出展者による製品・技術セミナー

<http://jan2013.tems-system.com/exhisearch/INW/jp/workshop.aspx>

開催日 2013年1月16日(水)  
場所 出展社による製品・技術セミナーA会場  
時間 15:00-16:00  
内容 ウエハレベルパッケージ技術の誕生から現在、そして今後の技術展開、ビジネスモデルの変化について、キーワード毎に解説します  
講演者 技術顧問 若林 猛

## ● 本件に関するお問い合わせ先

株式会社テラミクロス

営業部：小松

電話：0428-32-1269